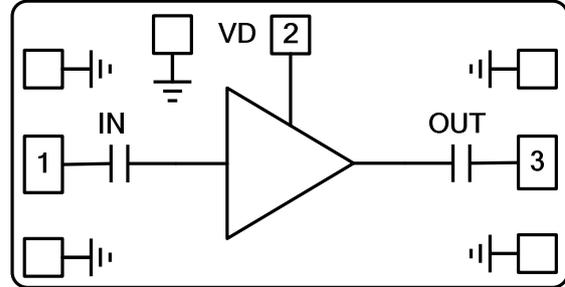




### 主要特点

- 工作频率: 2 - 6 GHz
- 增益: 23 dB
- 噪声系数: 2.8 dB
- P1dB: +23 dBm
- Psat: +24 dBm
- 供电: 自偏置 +5V @ 190 mA
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: 1.5 × 1 × 0.1 mm<sup>3</sup>

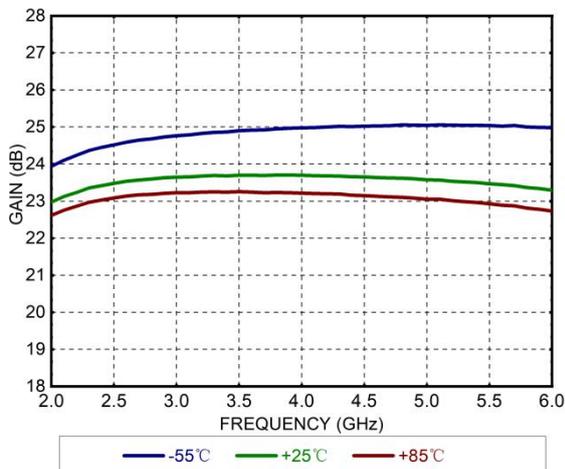
### 功能框图



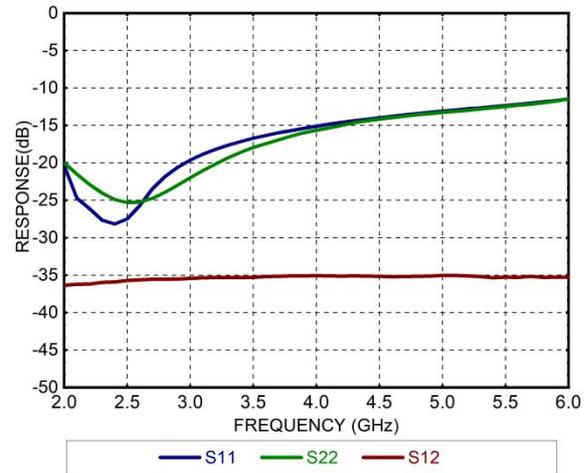
### 性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , $V_{DD} = +5\text{V}$ )

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	2-6			GHz
增益		23		dB
增益平坦度		±0.6		dB
输入回波损耗		15		dB
输出回波损耗		12		dB
输出功率 1dB 压缩点		23		dBm
饱和功率		24		dBm
OIP3		31		dBm
噪声系数		2.8		dB
工作电流	170	190	220	mA

### 增益 VS 温度

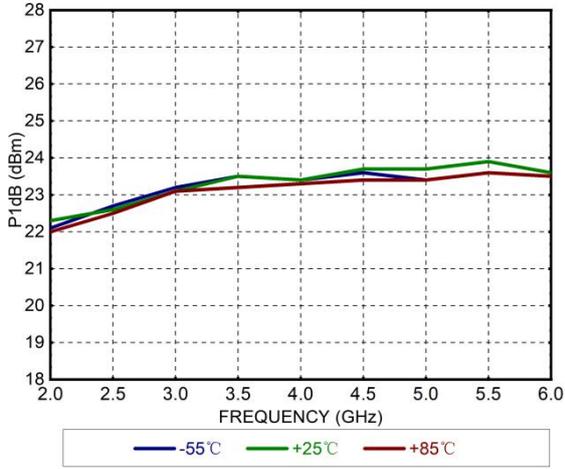


### 回波损耗&反向隔离

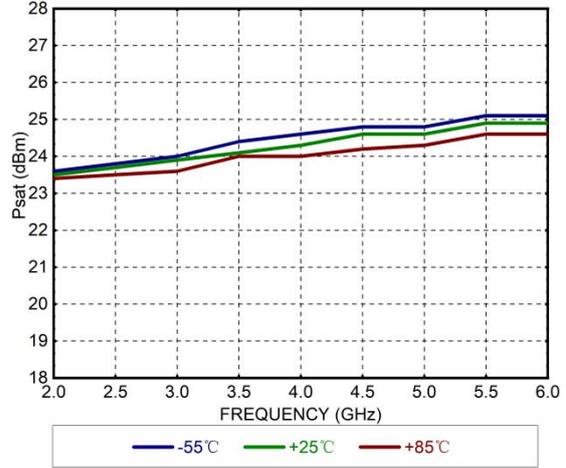




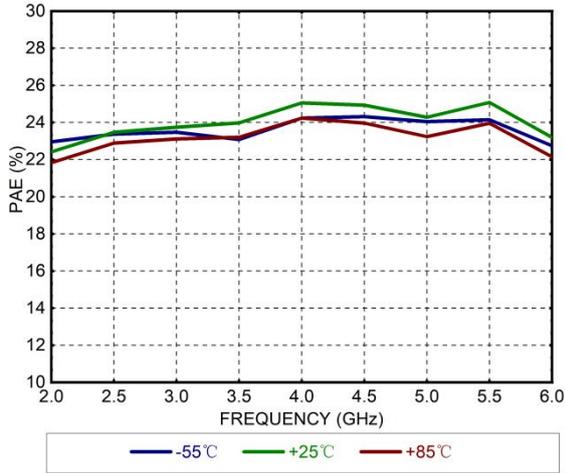
### 输出功率 $P_{-1}$ VS 温度



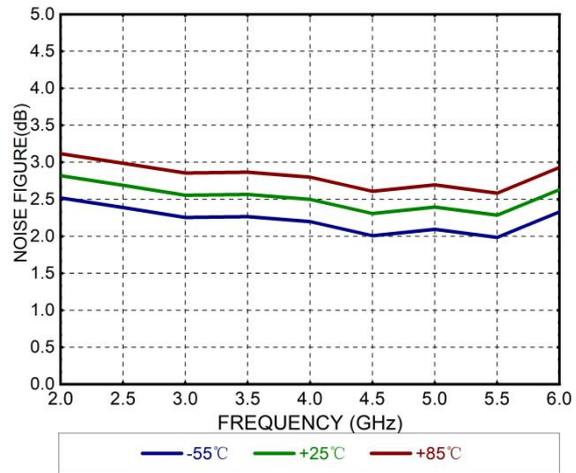
### 输出功率 $P_{sat}$ VS 温度



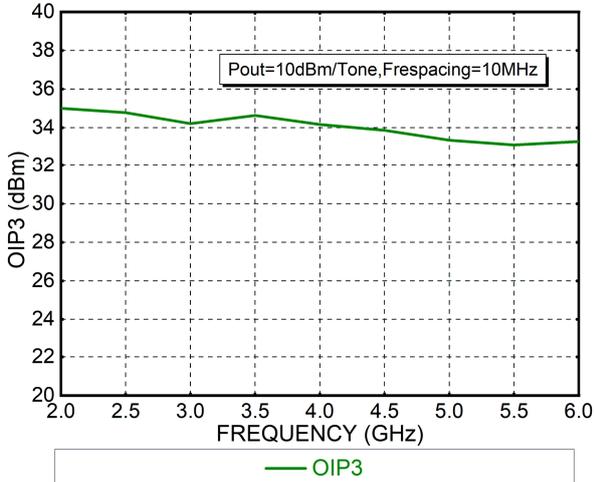
### PAE @ $P_{sat}$ VS 温度



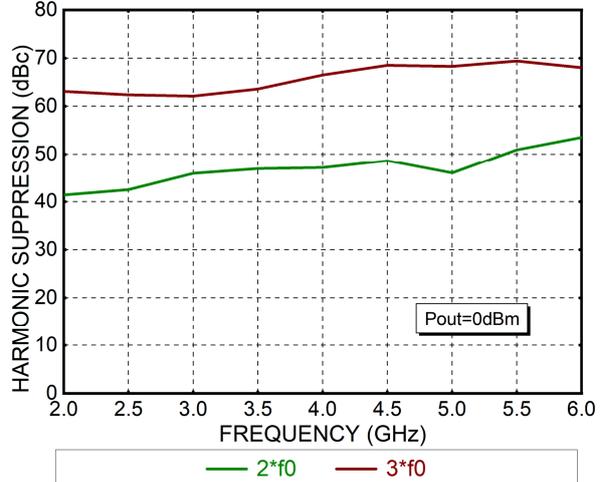
### 噪声系数 VS 温度



### OIP3



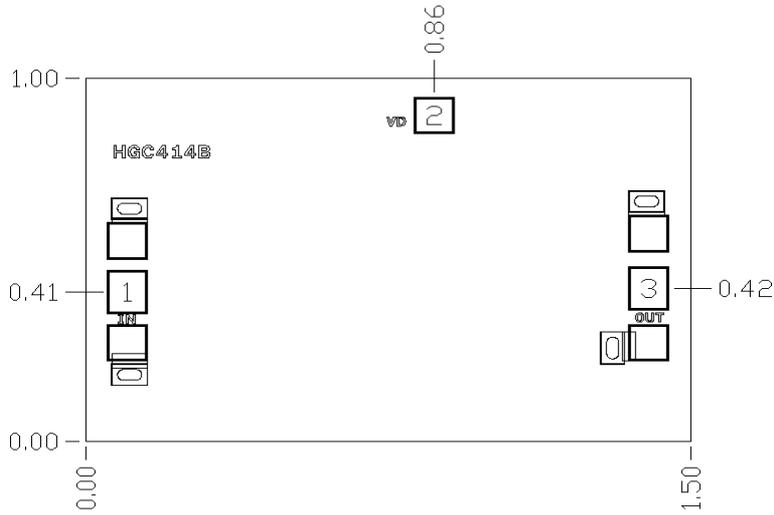
### 谐波抑制





## 物理参数

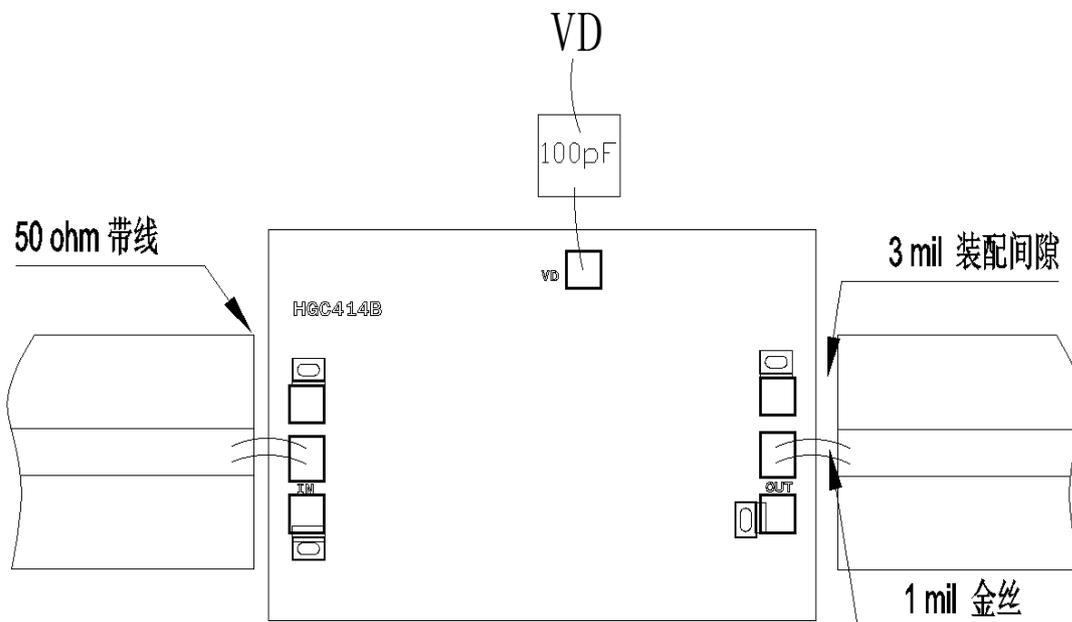
单位: mm



## 焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是射频输入端口, AC 耦合, 匹配至 50 Ohm, 不需要外接隔直电容
2	VD	该焊盘是电源端口, 需要外接 100pF 旁路电容
3	OUT	该焊盘是射频输出端口, AC 耦合, 匹配至 50 Ohm, 不需要外接隔直电容
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

## 推荐装配图



### 注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100  $\mu\text{m}$
3. 典型键合焊盘尺寸为 100\*100  $\mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 需要共晶烧结装配
8. 未标注的键合焊盘不需要连接
9. 钝化层信息：材质：SiN；厚度：0.5  $\mu\text{m}$ 。

### 极限参数

1. 电源电压：+6 V
2. 射频输入功率：+18 dBm
3. 储存温度：-65 ~ +150  $^{\circ}\text{C}$
4. 工作温度：-55 ~ +85  $^{\circ}\text{C}$